



CBLC9 模组规格书

文档版本: 20211115



目录

1 产品概述	2
1.1 特性	2
1.2 应用领域	2
1.3 更新说明	3
2 模组接口	5
2.1 尺寸封装	5
2.2 引脚定义	5
2.3 测试点定义	6
3 电气参数	7
3.1 绝对电气参数	7
3.2 正常工作条件	7
3.3 射频功耗	7
3.4 工作电流	8
4 射频参数	9
4.1 基本射频特性	9
4.2 Wi-Fi 发射性能	9
4.3 Wi-Fi 接收性能	9
4.4 蓝牙 LE 发射性能	10
4.5 蓝牙 LE 接收性能	10
5 天线信息	12
5.1 天线类型	12
5.2 降低天线干扰	12
6 封装信息及生产指导	13
6.1 机械尺寸	13
6.2 推荐封装	15
6.3 生产指南	15
6.4 推荐炉温曲线和温度建议	16
6.5 储存条件	17
7 模组 MOQ 与包装信息	19



CBLC9 一款集成所有外围器件的全集成单芯片。芯片集成了完整的 Wi-Fi 和 蓝牙 LE 应用需要的硬件和软件资源，可以支持 AP 和 STA 双角色连接，并同时支持蓝牙 LE 连接。运行速度最高可到 120 MHz 的 32-bit MCU 以及内置的 256 KB RAM，可以使得芯片支持平台云连接，并且 MCU 专为信号处理扩展的指令使其可以有效地实现音频编码和解码。

1 产品概述

CBLC9 内部集成了晶振，射频匹配电路和所有外围器件，拥有丰富的外设，如 PWM、I2C、UART、SPI、SDIO 以及 IrDA。多达六路的 32 位 PWM 输出使芯片非常适合高品质的 LED 控制。

1.1 特性

- 内置低功耗 32 位 CPU，可以兼作应用处理器
- 主频支持 120MHz
- 工作电压：3V~3.6V
- 外设：6×PWM
- Wi-Fi 连通性
 - 802.11 b/g/n
 - 通道1-14@2.4GHz
 - 支持 WEP,WPA/WPA2,WPA/WPA2 PSK (AES) 安全模式
 - 802.11b 模式下最大 +16dBm 的输出功率
 - 支持 STA/AP/STA+AP 工作模式
 - 支持 SmartConfig 和 AP 两种配网方式（包括 Android 和 IOS 设备）
 - 工作温度：-40°C to 105°C
- 蓝牙 LE 连通性
 - 蓝牙模式支持最大 6 dBm 发射功率
 - 完整的蓝牙共存接口

1.2 应用领域

- 智能楼宇、园区
- 智慧家居、家电
- 智能插座、智慧灯
- 工业无线控制
- 婴儿监控器
- 网络摄像头
- 智能公交



1.3 更新说明



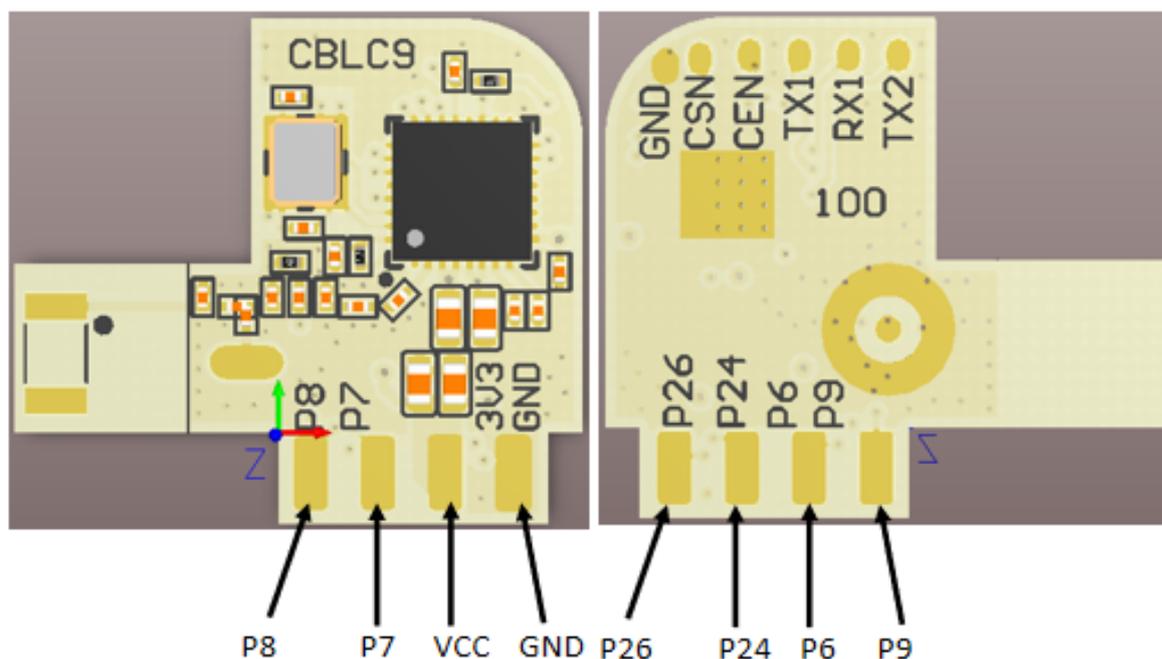
更新日期	更新内容	更新后版本
2020-11-24	新建文档	V1.0.0

2 模组接口

2.1 尺寸封装

CBLC9 共有 2 排引脚，引脚间距为 $2\pm 0.1\text{mm}$ 。

CBLC9 尺寸大小： $15\pm 0.35\text{mm}$ (W) $\times 16.8\pm 0.35\text{mm}$ (L) $\times 1.8\pm 0.15\text{mm}$ (H)。



2.2 引脚定义

引脚序号	符号	I/O 类型	功能
1	P9	I/O	支持硬件 PWM，对应 IC 的 P9
2	P8	I/O	普通 IO 引脚，对应 IC 的 P8
3	P6	I/O	支持硬件 PWM，对应 IC 的 P6
4	P7	I/O	支持硬件 PWM，对应 IC 的 P8

引脚序号	符号	I/O 类型	功能
5	P24	I/O	支持硬件 PWM，对应 IC 的 P24
6	VCC	P	模组的电源引脚 (3.3V)
7	P26	I/O	支持硬件 PWM，对应 IC 的 P26
8	GND	P	电源地

说明：P 表示电源引脚，I/O 表示输入输出引脚。

2.3 测试点定义

引脚序号	符号	I/O 类型	功能
TP1	RF	I/O	射频测试点
TP2	GND	P	接地点
TP3	CEN	I	复位引脚，内部 3.3V 上拉
TP4	U1_TXD	I/O	UART1_TX，用户串口 TX
TP5	U1_RXD	I/O	UART1_RX，用户串口 RX
TP6	U2_TXD	I/O	UART2_TX，LOG TX 口
TP8	CSN	I	射频校准上电前需外部拉低

3 电气参数

3.1 绝对电气参数

参数	描述	最小值	最大值	单位
Ts	存储温度	-55	125	°C
VBAT	供电电压	-0.3	3.9	V
静电释放电压 (人体模型)	TAMB-25°C	-4	4	kV
静电释放电压 (机器模型)	TAMB-25°C	-200	200	V

3.2 正常工作条件

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
Ta	工作温度	-40	-	105	°C
VBAT	供电电压	3	3.3	3.6	V
VOL	IO 低电平输出	VSS	-	VSS+0.3	V
VOH	IO 高电平输出	VBAT-0.3	-	VBAT	V
I _{max}	IO 驱动电流	-	6	20	mA

3.3 射频功耗

工作状态	模式	速率	发射功率/接收	平均值	峰值 (典型值)	单位
发射	11b	11Mbps	+16dBm	279	315	mA
发射	11g	54Mbps	+14dBm	260	282	mA
发射	11n	MCS7	+13dBm	257	277	mA

工作状态	模式	速率	发射功率/接收	平均值	峰值 (典型值)	单位
接收	11b	11Mbps	连续接收	74	88	mA
接收	11g	54Mbps	连续接收	74	88	mA
接收	11n	MCS7	连续接收	74	88	mA

3.4 工作电流

工作模式	工作状态, Ta=25℃	平均值	最大值 (典型值)	单位
快连配网状态 (蓝牙配网)	模组处于快连配网状态, Wi-Fi 指示灯快闪	79	263	mA
快连配网状态 (AP 配网)	模组处在热点配网状态, Wi-Fi 指示灯慢闪	80	310	mA
快连配网状态 (EZ 配网)	模组处于快连配网状态, WIFI 指示灯快闪	97	316	mA
网络连接状态	模组处于联网工作状态, Wi-Fi 指示灯常亮	47	308	mA
弱网连接状态	模组和热点处于弱网连接状态, Wi-Fi 指示灯常亮	205	350	mA
断网状态	模组处于断网工作状态, Wi-Fi 指示灯常灭	79	263	mA

4 射频参数

4.1 基本射频特性

参数项	详细说明
工作频率	2.412~2.484GHz
Wi-Fi 标准	IEEE 802.11b/g/n(通道 1-14)
数据传输速率	11b:1,2,5.5, 11 (Mbps) 11g:6,9,12,18,24,36,48,54(Mbps); 11n: HT20 MCS0~7;
天线类型	贴片陶瓷天线, 增益 1.2dbi

4.2 Wi-Fi 发射性能

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
RF 平均输出功率, 802.11b CCK Mode 11M	-	16	-	dBm
RF 平均输出功率, 802.11g OFDM Mode 54M	-	14	-	dBm
RF 平均输出功率, 802.11n OFDM Mode MCS7	-	13	-	dBm
频率误差	-10	-	10	ppm

4.3 Wi-Fi 接收性能



参数项	最小值	典型值	最大值	单位
PER<8%, RX 灵敏度, 802.11b DSSS Mode 11M	-	-85	-	dBm
PER<10%, RX 灵敏度, 802.11g OFDM Mode 54M	-	-72	-	dBm
PER<10%, RX 灵敏度, 802.11n OFDM Mode MCS7	-	-68	-	dBm
PER<10%, RX 灵敏度, 蓝牙 LE 1M	-	-94	-	dBm

4.4 蓝牙 LE 发射性能

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	2402	-	2480	MHz
空中速率	-	1	-	Mbps
发射功率	-20	6	20	dBm
频率误差	-150	-	150	KHz

4.5 蓝牙 LE 接收性能

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
RX 灵敏度	-	-93	-	dBm
最大射频信号输入	-10	-	-	dBm



参数项	最小值	典型值	最大值	单位
互调	-	-	-23	dBm
共信道抑制比	-	10	-	dB

5 天线信息

5.1 天线类型

CBLC9 贴片 3216 封装陶瓷天线。

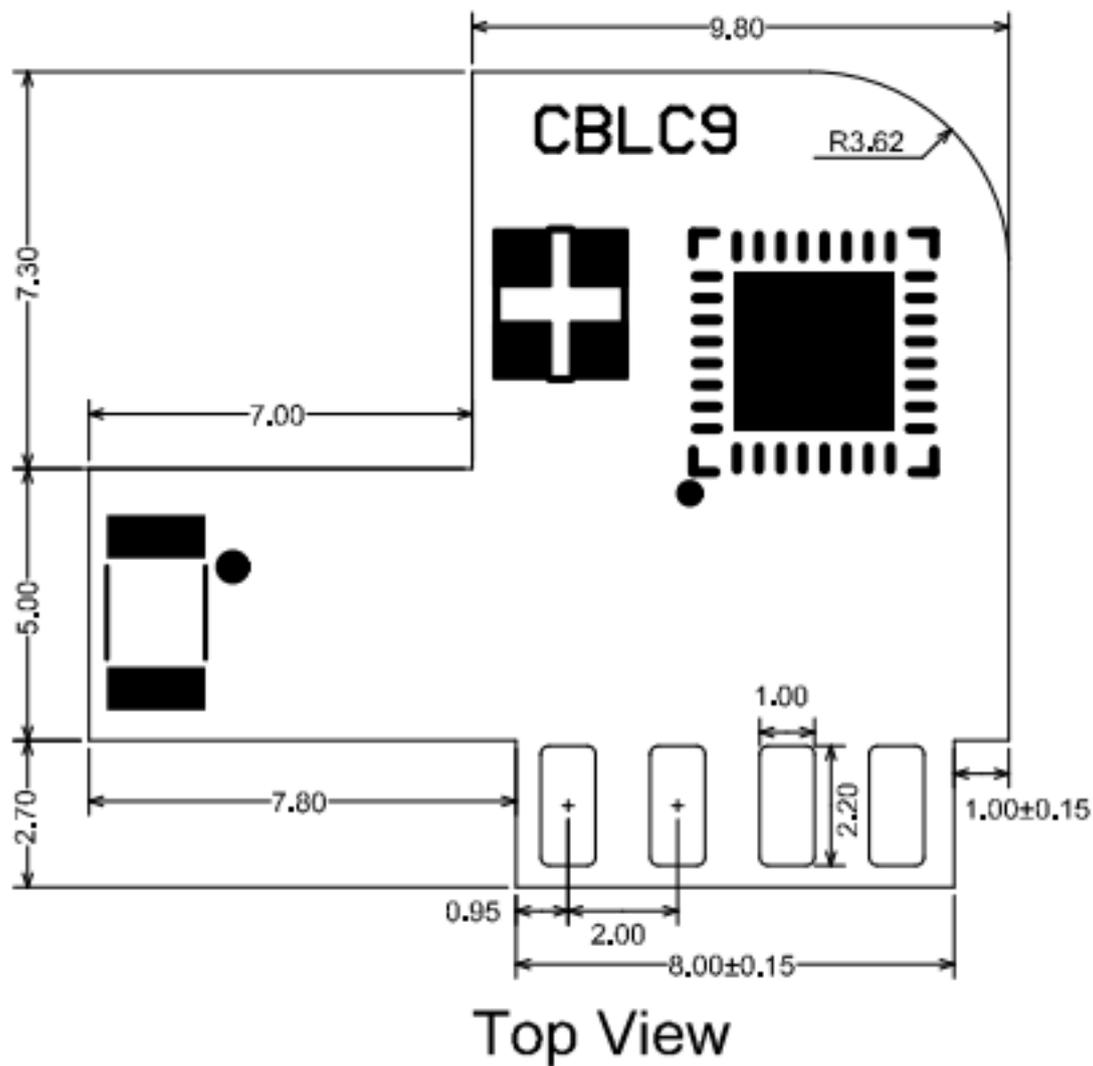
5.2 降低天线干扰

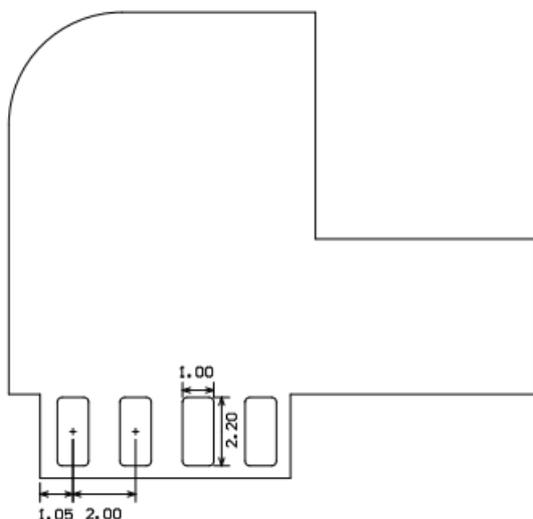
在 Wi-Fi 模组上使用贴片陶瓷天线时，为确保 Wi-Fi 性能的最优化，建议模组天线部分和其他金属件距离至少在 15mm 以上。用户 PCB 板在天线区域勿走线甚至覆铜，以免影响天线性能。

6 封装信息及生产指导

6.1 机械尺寸

CBLC9 PCB 尺寸大小: $15\pm 0.35\text{mm}$ (W) \times $16.8\pm 0.35\text{mm}$ (L) \times $1\pm 0.1\text{mm}$ (H)。





Bottom View



单位: mm
Unit: mm

模组外形公差: $\pm 0.35\text{mm}$
Module form factor tolerance: $\pm 0.35\text{mm}$

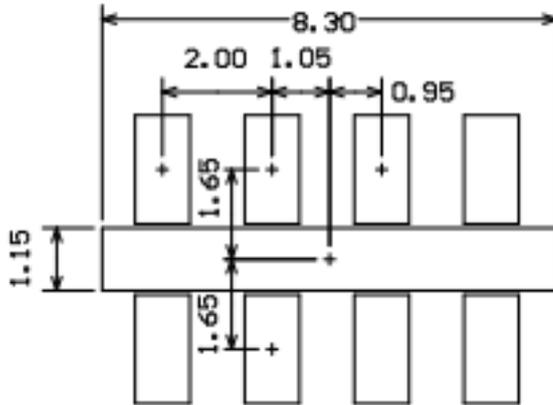
板厚公差: $\pm 0.1\text{mm}$
Plate thickness tolerance: $\pm 0.1\text{mm}$

器件高度标注为最大值
The device height is marked as the maximum

Side View

说明: 默认的模组外形尺寸公差为 $\pm 0.35\text{mm}$, 关键尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$ 。关键尺寸如果客户有明确要求, 请沟通后在规格书中进行明确的标定。

6.2 推荐封装



6.3 生产指南

1. 出厂的直插式模组建议优先使用波峰焊接设备焊接，在无法使用波峰焊接设备焊接时才使用手工焊接，拆开包装后建议在 24 小时内完成焊接，否则需放置在湿度不超过 10%RH 的干燥柜内，或重新进行真空包装并记录暴露时间，总暴露时间不超过 168 小时。
2. 焊接所需设备和材料：
 - 波峰焊设备
 - 波峰焊接治具
 - 恒温烙铁
 - 锡条、锡丝、助焊剂
 - 炉温测试仪
3. 烘烤所需仪器或设备：
 - 柜式烘烤箱
 - 防静电耐高温托盘
 - 防静电耐高温手套
4. 出厂的模组当出现可能受潮的情况下需要进行烘烤：
 - 拆封前发现真空包装袋破损
 - 拆封后发现包装袋内没有湿度指示卡
 - 拆封后如果湿度指示卡读取到 10% 及以上色环变为粉色
 - 拆封后总暴露时间超过 168 小时

- 从首次密封包装之日起超过 12 个月

5. 烘烤参数如下：

- 烘烤温度：卷盘包装 60℃，小于等于 5%RH；托盘包装 125℃，小于等于 5%RH（耐高温托盘非吸塑盒拖盘）
- 烘烤时间：卷盘包装 48 小时；托盘包装 12 小时
- 报警温度设定：卷盘包装 65℃；托盘包装 135℃
- 自然条件下冷却到 36℃ 以下后，即可进行生产
- 若烘烤后暴露时间大于 168 小时没有使用完，请再次进行烘烤
- 如果暴露时间超过 168 小时未经过烘烤，不建议使用波峰焊接工艺焊接此批次模组，因模组为 3 级湿敏器件超过允许的暴露时间很可能受潮，进行高温焊接时可能导致器件失效或焊接不良。

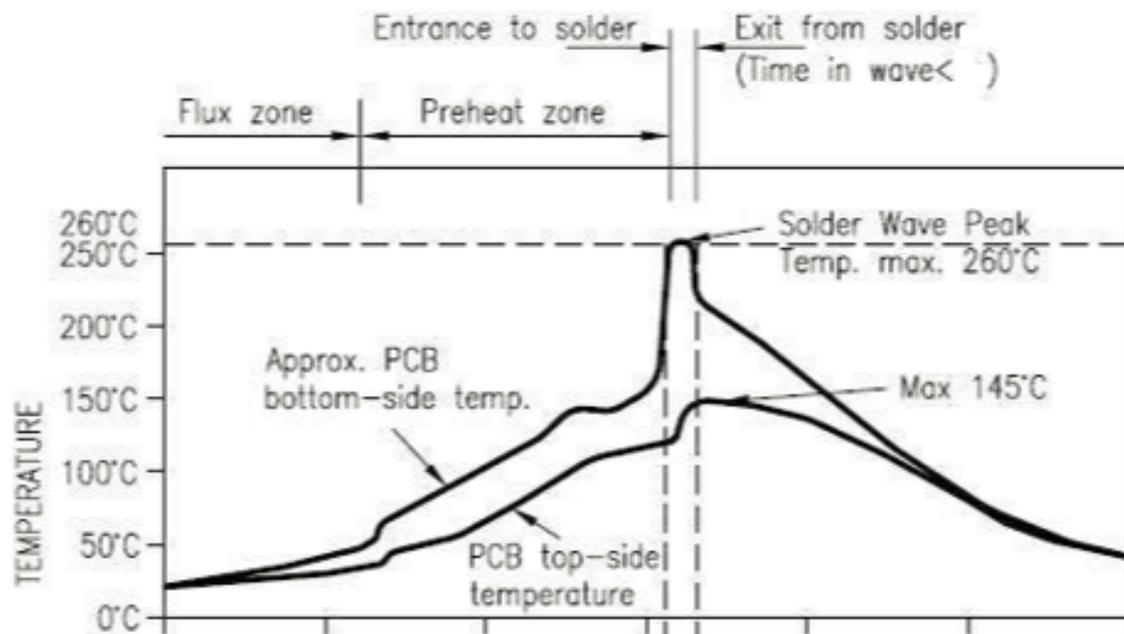
6. 在整个生产过程中请对模组进行静电放电（ESD）保护。

7. 为了确保产品的良好品质，生产时需重点关注助焊剂的喷涂量，波峰高度，波峰焊锡缸内的锡渣和铜含量是否超标，波峰焊接治具开窗和治具厚度是否合适以及波峰焊接炉温曲线的合理性。

6.4 推荐炉温曲线和温度建议

请参考波峰焊接炉温建议进行炉温设定，峰值温度 $260^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，波峰焊接温度曲线如下图所示：

DIP Type Product Pass Wavesolder Graph



焊接温度建议:

波峰焊接炉温曲线建议

手工焊接温度建议

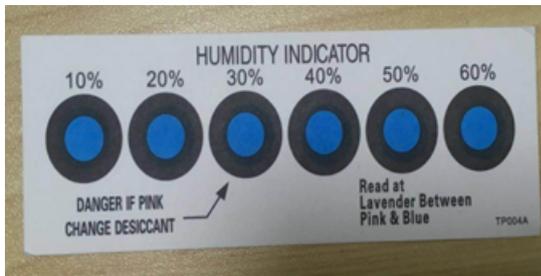
预热温度	80-130°C	焊接温度	360°C±20°C
预热时间	75-100S	焊接时间	小于 3S/点
波峰接触时间	3-5S	NA	NA
锡缸温度	260±5°C	NA	NA
升温斜率	≤2°C/S	NA	NA
降温斜率	≤6°C/S	NA	NA

6.5 储存条件

出厂的模组存储条件如下:

- 防潮袋真空包装储存在温度 < 40°C、湿度 < 90%RH 的环境中。
- 干燥包装的产品，保质期为从包装密封之日起 12 个月的时间。

- 密封包装内装有湿度指示卡：





警示
本隔潮袋装有
潮湿敏感器件

等级 (MSL)

3

如果缺省，
见相邻的条码标签

1. 经计算密封袋内器件的保存期限：在<40 °C及<90%相对湿度 (RH)条件下为12 个月
 隔潮袋密封日期：_____ 详见生产日期
如果缺省，见相邻的条码标签
2. 封装本体峰值温度：_____ 260 _____ °C
如果缺省，见相邻的条码标签
3. 打开袋后，将要采用再流焊接或者其它高温工艺加工的器件必须
 - a) 在车间环境≤30 °C/60% RH条件下，在 _____ 168 _____ 小时
 内贴装，或 如果缺省，见相邻的条码标签
 - b) 按照J-STD-033贮存
4. 贴装前，器件要求烘烤，如果：
 - a) 在23±5 °C下读取时，对于等级为2a-5a级的器件，湿度指示卡读数>10%；或者对于等级为2级的器件，湿度指示卡读数>60%
 - b) 上述的3a或者3b条件不满足
5. 如果要求烘烤，参见IPC/JEDEC J-STD-033中的烘烤程序。

注 1: IPC/JEDEC J-STD-020规定了等级和封装本体温度



7 模组 MOQ 与包装信息

产品型号	MOQ (pcs)	出货包装方式	出货包装方式	每箱包装卷盘数
CBLC9	4400	载带卷盘	1100	4